

注意事項

- 1.使用限制: 本機台屬於半導體製程前段機台
僅能使用 8 吋矽晶圓基板，玻璃基板、破片、皆禁止使用。
- 2.由於不同曝光機台所使用之光阻厚度不同，不同曝光方式所能蝕刻之最深厚度亦有所不同，需特別注意(可參閱技術資料之蝕刻選擇比)
- 3 本機台裝有終點偵測器，任何蝕刻製程最好先使用控片做蝕刻測試並依狀況以光學量測儀器或 P-10、SEM 做蝕刻速率量測及剖面觀測，送件時務必要加送測試片。
- 4.特殊製程需以 SEM 或 AFM 觀測測試結果再進行施做，SEM 或 AFM 的觀測需委由材料分析組進行觀測。
- 5.非標準製程務必和機台負責工程師連絡討論可行性，欲送件前如有任何問題請與機台負責工程師連絡。